全自動万能回転型ミクロトーム（樹脂包埋標本対応）

機種名

ライカマイクロシステムズ株式会社
型式　RM2265
機器番号：0572-00

用途概要

硬いブロックを安定したスピードで切ることができ、様々なタイプの標本から高品質な切片の作製が可能です。

主な仕様

切片厚設定範囲：0.25-100μm
- 0.25
- 0.50-5.0μm間、0.5μm刻み
- 5.0-20.0μm間、1.0μm刻み
- 20.0-60.0μm間、5.0μm刻み
- 60.0μm-100.0μm間、10.0μm刻み

最大試料サイズ（L×H×W）：50×60×40mm
ナイフホルダー：E. LOWプロファイル　ウォーターボード付

持込品、注意点等

【持込品】
ミクロトーム用の替刃をご持参ください。
※・使用される刃は大変よく切れ危険です。取り扱いには十分注意して下さい。

【注意点】
パラフィンの削りカスの廃棄について：
組織等が含まれていますので、「感染性廃棄物」に分別して廃棄してください。

ご利用申し込み　：　利用の2営業日前までにお願いします。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。